

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(记录表编号：2026-001)

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 一对一沟通	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2026年3月30日		
地点/方式	线上会议		
参与单位或人 员（排名不分 先后）	艾希资本、博时基金、财通基金、财通证券、诚通证券、创金合信、德邦基金、第一上海证券、东兴基金、方正证券、富安达、广发证券、国联民生、国融基金、国盛证券、国泰证券、国信证券、国元证券、浩成资产、和谐健康、HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited、华安财保资产、华福证券、华泰证券、华西基金、华夏基金、华源证券、汇华理财、嘉实基金、景领投资、景泰利丰、玖歌投资、开源证券、凯石投资、宽远资产、LyGH Cap、美林证券、诺德基金、盘京投资、Point72 HongKong Limited、千里资本、前海开源基金、青岛鸿竹、泉果基金、锐方（上海）、上海鹤禧、上海胤胜、上海证券、上汽金控、申万宏源、深圳宽源、深圳前海荣金、深圳泰聚、十溢投资、世嘉控股、太平基金、听畅资产、潼骁投资、途灵资产、西部证券、新华基金、新华资产、信达澳亚基金、兴业证券、兴银理财、易方达、银河基金、驭乘投资、长盛基金、长信基金、招商信诺、招商证券、中庚基金、中海基金、中金公司、中泰证券、中信保诚、中信建投、中信证券、中银基金、中胤信弘、中原证券、珠海横琴智合远见		
上市公司 接待人员	总裁：刘羽先生 副总裁：王俊先生 财务总监：孙君磊先生 董事会秘书：黄恬先生		

<p>投资者关系 活动主要内容</p>	<p>一、经营情况简介</p> <p>2025 年，面对复杂多变的外部环境，公司积极应对，扎实推进战略落地，既实现了经营业绩稳中有进、不断提质，又推动了长期产业赛道的战略卡位与核心竞争力的巩固深化，形成技术迭代与市场拓展的良性循环，为公司可持续高质量发展注入新动能。报告期内，公司实现营业收入 153.08 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 12.31 亿元，同比增长 5.30%。</p> <p>下游领域发展：积极把握 AI 时代浪潮，持续强化“1+1+N”业务布局。</p> <p>汽车电子业务全球龙头优势进一步巩固。公司紧跟行业发展趋势，积极配合客户进行联合研发，深入洞察客户需求，开发新产品，获取新项目，同时持续拓展新客户，为汽车电子业务增长注入新机；同时，持续优化车规级产品的产线布局，提升规模化生产能力与交付效率。</p> <p>重点发展通信与数据基础设施业务。在 AI 算力基础设施领域完成核心能力构建与市场基础夯实，形成了多维度竞争优势，取得了阶段性经营成果，开启规模化增长新阶段。受益于与全球 AI 计算基础设施领先企业客户的合作持续深化，形成良好的市场示范效应，公司获得了多家 AI 领先客户的广泛关注与合作接洽，加快了市场拓展效率。</p> <p>重点工厂建设：面对来自全球的强劲需求，公司正在加大高端产能战略投入，支撑长期战略规划落地。</p> <p>珠海金湾基地是公司提升高端产品占比、聚焦 AI+打造新增长曲线的关键支撑。报告期内，公司综合研判下游市场需求和 AI 算力产品技术发展趋势，高效开展珠海金湾基地的扩产及技术能力提升等多项重点工作，精准卡位 AI 算力增长需求，着力提升高阶 HDI、HLC、SLP 全流程生产能力，攻坚超高厚径比、超高层数、高阶数、超精细线路板制造，部分升级的产线在报告期内已投产见效，既保障了短期产能释放、快速响应客户需求，也有序布局了中长期高端产能的规模化储备。2025 年下半年，公司明显加大了对金湾基地的战略投入，进行必要的深蹲蓄力。</p> <p>泰国生产基地是公司国际化布局的重要一子，报告期内已完成主体结构封顶，公司正在按计划推进设备安装及客户导入等工作，预计于 2026 年内</p>
--------------------------------	--

投产，投产节奏和行业需求高度契合，与国内生产基地形成技术共享、产能互补、客户联动的协同效应，为公司海外业务的持续扩张筑牢安全底座。

关于公司未来发展的讨论：

2026年，在外部不确定性扰动加剧之下，公司将保持战略定力，集中精力办好自己的事，紧扣下游市场需求，科学规划产能建设，稳步推进高端产能释放与全球化产能布局，加速客户导入，提升高端产品占比，用实实在在的业绩、更高质量的发展回报广大股东期待。

二、投资者问答

问：公司未来3-5年的资本开支计划？

答：公司未来大额资本开支聚焦高端产能建设、持续研发投入及数字化转型等方面，会根据市场需求动态调整，长期投资会保持稳健而审慎的节奏。

问：请问光模块产品的出货情况如何？

答：光模块业务是公司持续关注并聚焦能力提升的领域，已批量生产10G/25G/100G/200G/400G/800G光模块PCB产品，报告期内1.6T光模块PCB已开始出货，公司积极开拓新客户，进一步扩大业务规模。

问：AI需求推动上游材料性能升级，成本及加工难度均有提升，公司是否已有相应的技术储备？

答：公司构建了完善的材料数据库，对支持高频高速传输、具备高散热能力的材料进行了系统研究，已具备M7至M9级别及PTFE材料的量产加工能力，正根据客户需求开展更高性能材料的研发与验证工作，包括M9+级材料等下一代超低损耗高速材料。

问：AI算力客户关系的储备及合作进展？如何看待AI PCB厂商的竞争格局？

答：公司与全球AI计算基础设施领先企业客户的合作持续深化，并获得多家AI领先客户的广泛关注与合作接洽。AI技术进步催生了全球科技产业的深度革新重构，PCB也迎来了新一轮产能扩张及技术升级的重要机遇，市场的蛋糕足够大，整个价值链协同进步，公司在技术储备、高端产能、产

	<p>品稳定性与一致性等方面构建了多维优势，有信心在竞争中占据一席之地。</p> <p>问：公司汽车电子业务在过去几年保持高速增长，未来是否有可能延续增长趋势？判断的依据是什么？</p> <p>答：公司对汽车电子业务未来几年的增长仍持乐观态度。第一，与全球领先企业客户形成稳固战略合作关系。公司积累了大量优质汽车客户，公司的 PCB 产品已广泛应用于全球前十大汽车集团的产品中，汽车客户对供应商的资质要求极高，认证周期漫长，供应壁垒高，客户形成稳定供应关系后一般不会轻易更改供应体系，因而确定性和稳定性较好。第二，紧跟市场趋势和客户需求，提升高端产品占比。公司有能力供应一辆汽车所需的所有 PCB，以高可靠的产品深度赋能汽车智能化与电动化，持续加强对 HDI、高频高速、厚铜及嵌入式 PCB 产品的研发与供应，随着高阶智能驾驶功能快速下沉、域控制器前装渗透率持续提升、800V 高压平台加速普及，公司将全面提升在汽车电动化、智能化领域的竞争力和市场份额。第三，持续优化车规级产品的产线布局，提升规模化生产能力与交付效率。赣州景旺于报告期内顺利投产，产能爬坡顺利，盈利能力逐步提升，更好地满足客户对汽车电子多层 PCB 的需求。</p> <p>问：是否有后续的分红指引？</p> <p>答：公司坚持科学、持续、稳定的利润分配政策和决策机制，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，积极回报股东。</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件	无
记录时间	2026 年 3 月 30 日整理